

SIIP China 合作培训

2018 年人工智能芯片技术和应用研讨会

一、活动安排

(一) 名家芯思维

“芯动力”人才计划 2018 年人工智能芯片技术和应用研讨会

时间：2018 年 6 月 6 日（周三）

地点：南京瑞斯丽酒店（南京市浦口区浦滨路 207 号）

形式：定向邀请、前 100 名限免

主办方：工业和信息化部人才交流中心

人工智能芯片技术和应用研讨会会议程		
时间	内容	主讲人/主持人
8:30-9:00	来宾签到	
9:00-9:10	开幕致辞	
9:10-9:40	VLSI Optimization for DSP and Deep Learning	王中风 南京大学电子科学与工程学院特聘教授，IEEE Fellow
9:40-10:10	可重构系统的进步	Wayne Luk 英国帝国理工学院教授，英国皇家工程院院士，IEEE Fellow

10:10-10:40	人工智能视觉系统芯片研究及发展趋势	吴南键 博士生导师，中国科学院研究生院教授
10:40-11:10	物联网边缘计算与片上智能系统	郑立荣 复旦大学信息科学与工程学院院长
11:10-11:40	Architectures and Industrial Trends for AI Chips (人工智能芯片的体系结构和应用趋势)	何磊 美国加州大学洛杉矶分校教授
11:40-13:30	午餐	
13:30-14:00	人工智能和EDA的相互促进和发展	王琦 南京凯鼎信息科技有限公司 CEO
14:00-14:30	Hardware / Software co-design for Efficient Deep Learning Inference	陈忠民 深鉴科技芯片研发副总裁
14:30-15:00	人工智能技术最新进展以及面向人工智能的深度学习平台介绍	王士进 科大讯飞研究院副院长
15:00-15:30	待定	待定
15:30-16:00	Chip.ai v. s. Net.ai: Scaling for Edge Inference of Deep Neural Networks	史弋宇 美国圣母大学计算机科学与工程系副教授
16:00-17:00	圆桌论坛（我国人工智能芯片面临的机遇和挑战）	

（二）第60期国际名家讲堂

时间：2018年6月7日-8日（周四-周五）

地点：南京江北新区产业技术研创园

(南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 3 楼 316)

主题：人工智能时代的开源硬件及人工智能芯片压缩和构架

专家：陈容、何磊

注册费：3800 元/人（芯动力合作单位 3300 元/人）

(专家介绍、讲堂大纲及**补助政策**等更多具体信息请见**附件 1**)

二、报名方式

(一) 邮件报名

1. 人工智能芯片研讨会

发送邮件至 SIIP_China@semichina.org;

邮件题目格式为：“报名+人工智能芯片研讨会+单位名称+人数”

邮件内容：含有姓名、单位、部门及职务、电话、邮箱。

2. 国际名家讲堂

填写报名回执表（见**附件 2**）并发送 Word 邮件至

SIIP_China@semichina.org;

回执表文件名和邮件题目格式为：“报名+第 60 期+单位名称+人数。”

第 60 期国际名家讲堂——“人工智能时代的开源硬件及人工智能芯片压缩和构架”活动通知

一、专家介绍



陈容

硅谷 DEEOCEPTION(深度感知)科技公司 CEO

德国杜伊斯堡-爱森大学博士后

个人履历:

上海交通大学信息与信号处理博士学位，德国杜伊斯堡-爱森大学博士后。德国公司-MIMOON（现属于 Wireless Telecom Group, Inc）工作六年，主要参与的是移动通信软件无线电项目，深入理解和应用不同的微处理。

之后加入 Cadence Design System (Tensilica processor IP part) 前往美国加州硅谷工作，在 Cadence 主要是参与通信信号处理 DSP 及计算机视觉处理 DSP 的开发和部分售前技术支持工作。

现担任 DEEPCEPTION（深度感知科技）CEO，主要研发人工智能芯片。



何磊

加州大学洛杉矶分校电气工程系教授、
清洁能源研究中心主任

个人履历：

何磊教授在电路与系统，物联网，电动车等领域发表 200 多篇论文(H-index 39，总引用超 5900 次)。担任过 Cisco, IBM, Intel, HP, Cadence, Synopsys, 时代新能源(ATL)，华大九天等公司技术顾问，创办或共同创办 5 家涉及 EDA，云计算，物联网，和人工智能的高科技公司。目前研究重点为 FPGA，物联网，以及人工智能芯片与应用。

二、讲堂大纲

1. 开源硬件的历史、现状 (DARPA 开源项目，RISC-V 开源处理器项目)
2. 开源硬件的未来
3. 人工智能时代开源硬件
4. NIVIDA 的人工智能开源硬件 (DLA)

5. 如何应用开源硬件提高人工智能计算平台的发展

6. 人工智能开源硬件计算平台实践

7. 网络压缩：卷积神经网络压缩、卷积神经网络加速、循环神经网络压缩和加速等

8. 硬件加速：介绍加速度、加速度的并行性、内核/输入通道并行性、输入特性映射并行性、) 输入频道、输出频道并行、二进制网络硬件实现、压缩和架构的讨论、循环神经网络加速

三、组织安排

活动时间：2018年6月7 - 8日（2天）

活动地点：南京江北新区产业技术研创园

（南京市浦口区团结路99号孵鹰大厦A座3楼）

四、注册费用

1. 注册费：3800元/期（2天）

本期国际名家讲堂，南京本地单位（高校、企业等）学员合计共有10个免费名额，名额有限，主办方执行最终选择权。

注：费用含授课费、场地费、资料费、活动期间餐饮，不含学员交通、住宿等费用（学员自理）。

2. 芯动力合作单位学员：3300 元/期

国信芯世纪南京信息科技有限公司为本期国际名家讲堂开具发票，发票内容为培训费。请于 2018 年 6 月 6 日前将注册费汇至以下账户，并在汇款备注中注明款项信息（第 60 期+单位+参会人姓名）。

付款信息：

户 名：国信芯世纪南京信息科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京浦珠路支行

帐 号： 4301014509100090749

或请携带银行卡至活动现场，现场支持 POS 机付款。

附件 2 (讲座名称) **报名回执表**

单位名称						
通讯地址						
参加人员						
姓名	拼音	部门	职务	电话	手机	Email
单位人事部门联系人						
姓名	部门	职务	电话	手机	Email	
发票信息						
发票抬头						
发票内容及类型			内容为“培训费”，类型为增值税发票，如需开具，请完整填写下述发票信息表。			

注 1：通讯地址为可以送达快递的地址。

注 2：姓名拼音用于制作证书，请学员仔细填写，格式要求为全拼、姓和名分开、首字母大写，如张三三拼音为 Zhang Sansan。

注 3：请在讲座开始前汇款到以下账户，并在**汇款备注中注明款项信息：讲座名称+单位名称+姓名或人数**

户 名：国信芯世纪南京信息科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京浦珠路支行

帐 号：4301014509100090749

或请携带银行卡至活动现场，现场支持 POS 机付款。